

駐斯洛伐克代表處經濟組 函

地址：Mostova 2, 81102, Bratislava,
Slovakia

承 辦 人：經濟組

聯絡電話：(421-2)5825-3224

電子郵件：slovakia@sa.moea.gov.tw

受文者：台灣區車輛工業同業公會

發文日期：中華民國115年10月9日

發文字號：斯經字第1150000096號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：有關斯洛伐克啟動戰略關鍵技術補助計畫，每案最高補助
80萬歐元事，請卓參辦。

說明：

- 一、依據斯洛伐克經濟部網頁及Pravda報財經版2026年10月8日報導辦理。
- 二、為落實歐盟戰略自主指導綱領並協助國內產業升級，斯洛伐克政府頃公布戰略性技術專案資助計畫，核定境內依法設立之登記企業，凡投入符合歐盟關鍵技術發展方向之研發計畫，每項專案最高可申請獲得80萬歐元（約合新台幣2,800萬元）無償現金補助，旨在引導斯洛伐克傳統工業轉型，藉由財政補貼降低企業投入中高度技術風險（TRL 4至TRL 7）研發計畫之資金門檻，促進技術原型打造、實驗室概念驗證（PoC）及工業規模化試產。
- 三、斯洛伐克長年高居全球人均汽車產量第一大國（現有福斯VW、法國Stellantis、韓國Kia、Jaguar Land Rover等四大汽車組裝廠，另中國吉利集團Volvo電動車Kosice新廠預

計2027年初試生產)。根據投資暨貿易發展局(SARIO)數據,斯洛伐克目前有超過360家Tier 1及Tier 2供應商,然境內產業生態鏈多以中低階零組件沖壓、線束組裝及結構件製造為主,缺乏高附加價值之研發設計與核心零組件自主量能。面對歐洲汽車產業整體朝向電動化轉型衝擊,斯國政府亟需培育本土具深科技(Deep Tech)研發能力之創新型企業,防止傳統代工鏈被邊緣化。

四、本計畫接軌歐盟「歐洲戰略技術平台(Strategic Technologies for Europe Platform, STEP)」、「歐洲晶片法(European Chips Act)」以及「淨零工業法(Net-Zero Industry Act)」,補助關鍵領域包含:

(一)數位技術與深科技(Digital Technologies & Deep Tech):包含微電子封裝、寬能隙半導體(SiC/GaN)、車用專用晶片(ASIC)、邊緣運算、感測器及智慧自動化控制系統。

(二)潔淨與資源效率技術(Clean & Resource-efficient Technologies):包含電動車電池模組、電池管理系統(BMS)、儲能系統、氫能技術及工業減碳設備。

(三)生物技術與關鍵特種材料(Biotechnologies & Critical Technologies/Materials):包含先進生物醫藥檢測技術、特種工程聚合物及高階結晶防護複合材料。

五、對斯國總體經濟與外資生態鏈之影響評估:

(一)為在地中小企業提供轉型動能:在斯國當前公共財政緊縮(註:2027年一般政府財政赤字預估為GDP的4.94%,

政府債務預估約占GDP 66.9%，高於歐盟穩定與成長公約3%及60%基準）、銀行商業借貸利率維持相對高檔之總體環境下，每案最高80萬歐元專案補助實質為本土創新型中小企業提供關鍵研發及轉型活水，有助減緩高利率對科技投資的抑制效果。



- (二)加速區域高科技供應鏈整合：斯洛伐克地理位置居中，向西可對接捷克Brno及奧地利維也納科技走廊，向北緊鄰德國德勒斯登歐洲半導體重鎮。此項技術補助將加速斯洛伐克本土供應商切入台積電德勒斯登晶圓廠（ESMC）之外圍供應鏈生態圈，承接設備零組件、特用化學品封裝與精密加工外包等需求。

六、對我國產業界布局、契機與挑戰：

- (一)台斯聯合研發商機：斯國雖具備特定工程基礎，但普遍缺乏晶片設計硬體平台、高階微電子封裝製程及規模化試產量能。我商半導體IC設計、功率元件製造及智慧工廠系統整合業者，可透過與斯國獲補助企業簽署聯合研發協議（Joint R&D）或技術移轉合約，創造雙贏局面。

- (二)台斯半導體關鍵產業合作案衍生效益：

- 1、在工研院分別與斯洛伐克國家科學院(SAS)電機所及Bratislava科技大學(STUBA)建立可靠度測試實驗室之及建置電力模組組裝線示範效應下，斯洛伐克已於2024年9月成立「SLOVAK CHIPS」法人組織，串聯斯國高等教育部、經濟部、STUBA、SAS以及斯國半導體與電動車相關產業公會。





裝

訂

線



- 2、斯洛伐克晶片生態系與「斯洛伐克晶片卓越中心（SK CHIPS Competence Centre / SK CCC）」已凝聚超過20家產業核心成員，並與安森美（onsemi）、Danfoss / SEMIKRON、英飛凌（Infineon）等中東歐國際半導體巨頭，與Needronix、CMK等企業簽署保密協議（NDA）並建立實質合作，同時亦將在斯台資企業台達電、鴻海富士康等列為潛在合作對象。
- 3、除現有投入磊晶技術提升高壓氮化鎵功率元件開發的可行性研究與整合SiC模組開發輕型電動車逆變器技術探索外，台斯雙方已於 2025年7月由SAS、STUBA、工研院及國立陽明交通大學進一步展開「蕭特基二極體用氧化鎵磊晶技術」共同研究。
- 4、我國第三代半導體（SiC/GaN）模組封裝及車用零部件業者，可透過臺斯現有研發平台，跳過漫長的單一客戶摸索期，直接參與歐盟電動車（EV）動力系統與能源轉換供應鏈的在地化配套。
- 5、歐洲為降低對亞洲單一製造供應鏈之依賴，大力獎勵在地無晶圓廠（Fabless）與在地後段封裝測試（OSAT）。STUBA正積極以大學與SK CHIPS為基礎籌設衍生新創（Spin-offs），為歐洲客戶提供後段組裝與測試服務。我國半導體封裝設備廠（如打線機、迴焊爐、SAM 超音波品檢設備）及材料商（DBC/AMB 基板、燒結銀、封裝膠材），可乘勢成為斯國試產線與衍生新創的核心合格供應商，共同爭取歐盟晶片法案補貼案源。



(三)車用電子與智慧座艙供應鏈等台廠進駐卡位：我國在車載通訊、抬頭顯示器（HUD）、先進駕駛輔助系統（ADAS）及電池管理系統（BMS）具備成熟商品化模組。我商可藉由斯國推動此項戰略技術補助之契機，與斯國獲資助之Tier1及Tier2車用零組件廠商建立共同開發專案，加速打入德國、法國及斯國既有汽車組裝原廠（OEMs）供應鏈體系。

(四)規避歐盟綠色貿易與在地含量等非關稅貿易壁壘：歐盟針對電池碳足跡、零組件在地製造比率之規範日趨嚴苛。台資企業可藉由參與斯國戰略補助專案，在當地進行最後加工、軟硬體整合或技術授權，可有效取得「歐盟原產地標準（Made in EU）」身分，大幅規避未來歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、數位產品護照、研議中的歐盟工業加速法（IAA）及潛在的原產地規範、反補貼調查等風險。

正本：經濟部產業技術司、經濟部產業發展署

副本：經濟部投資促進司、經濟部國際貿易署、經濟部中小及新創企業署、財團法人工業技術研究院、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會、台灣先進車用技術發展協會

